

2021年6月16日

高导热材料开始量产

～有助于解决电子产品的高导热率、高信赖性散热问题～

瑞翁株式会社

瑞翁株式会社（社长：田中公章）宣布以独家技术所开发的片状散热材料（VB系列）正式开始投入量产。本产品在导热性、信赖性、作业性方面皆优于目前市面上常见的膏状散热材料，有望成为新一代电子产品散热问题的解决方案。

伴随服务器及通讯设备芯片信息处理的能力提升，散热方案的需求更是日益增加。

此次投入量产的“VB200”作为VB系列的标准产品，应用本公司擅长的特殊合成橡胶技术，与一般的散热材料相比，同时具备了垂直方向（Z轴）高导热性能（ $38\text{W/m}\cdot\text{k}$ ）及高信赖性两大特色。

在半导体行业，伴随着设备的小型化及运算效能高速化的发展，散热问题愈发成为不可避免的课题。本公司所开发的片状散热材料，不仅能为高效能半导体领域作出贡献，相信也能适用于所有同样需要散热问题解决方案的其他电子产品。

以上

突出性能	VB200
厚度	80 μm ～500 μm
导热系数（Z轴）	38 W/m·k
硬度*1	96
压缩率*2	11%

* 1 测量仪器为 Asker C 型硬度计

* 2 测量条件为厚度 100 μm 、温度 50 $^{\circ}\text{C}$ 、压力 0.3MPa